

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	招商证券、EIP、Willing、Optimas、中银基金、Quam Asset、长城资产国际、Commando、银河国际、银河证券、Morgan Stanley、北京信托、申万宏源、Point72、运舟资本、宁泉资产、西部证券
时间	2026年2月3日(周二)9:00-10:00 2026年2月3日(周二)10:00-11:00 2026年2月3日(周二)11:00-12:00 2026年2月3日(周二)14:00-15:00 2026年2月4日(周三)10:00-11:00 2026年2月5日(周四)9:00-10:00 2026年2月6日(周五)10:00-11:00
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司新产品 mSSD 的应用情况如何？如何理解这款产品的市场空间？</p> <p>答：公司 mSSD 采用 Wafer 级系统级封装（SiP），将主控、NAND、PMIC 等元件整合进单一封装体内，实现了从 Wafer 到产品化的一次性封装，省去了 PCB 贴片、回流焊等多道 SMT 环节，产品具备明显的制造成本优势。</p> <p>mSSD 作为传统 SMT 工艺 SSD 的升级形态，通过集成封装实现轻薄化、紧凑化，在满足存储协议低功耗要求、大幅降低空间占用的同时，保持了与传统 SSD 相当的性能水平，并具备更优异的物理特性。mSSD 作为一项重大的产品创新，市场前景广阔，正在多家头部 PC 厂商加快导入。</p> <p>2、公司与闪迪 UFS 产品合作的进展如何？</p> <p>答：包括公司在内的，全球目前仅少数企业具备在芯片层面开发 UFS4.1 产品的能力，与此同时，搭载公司自研主控的 UFS4.1 产品在制程、读写速度以及稳定性上优于市场可比产品。UFS4.1 作为消费级存储的高端产品，是 Tier1 大客户的旗舰智能终端机型的首选存储配置，具备广阔的市场空间。公司已与多家晶圆原厂及头部智能终端设备厂商构建了深度合作关系，以 UFS4.1 为代表的旗舰存储产品正在批量出货前夕。</p> <p>3、公司与哪些原厂有长期合作关系？晶圆供应上公司是否有充足保障？</p> <p>答：公司已与全球主要存储晶圆原厂建立了深层次、多角度的合作关系，并签署有长期供货协议（LTA）或商业合作备忘录（MOU），在存储晶圆供应方面具备较为深厚的基础。公司依托主控芯片、固件算法、封装测试的全栈能力，以及和上下游的深度协同机制，在晶圆供应结构性偏紧的环境下，构建起了差异化的供应保障能力与成长潜力。</p> <p>4、如何看待本轮存储周期的持续性和存储价格涨幅？</p>
-------------------	--

	<p>答：结合第三方机构信息来看，随着 AI 推理在系统架构与资源调度等方面的结构性变化，特别是键值缓存（KV Cache）与检索增强生成（RAG）技术的应用，AI 推理对存储的容量需求显著扩大，叠加 AI 基础设施快速扩张与 HDD 供应短缺，共同推动存储需求爆发式增长；受制于产能建设周期的滞后性，存储原厂资本开支回升对短期位元产出的增量贡献也将较为有限。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无